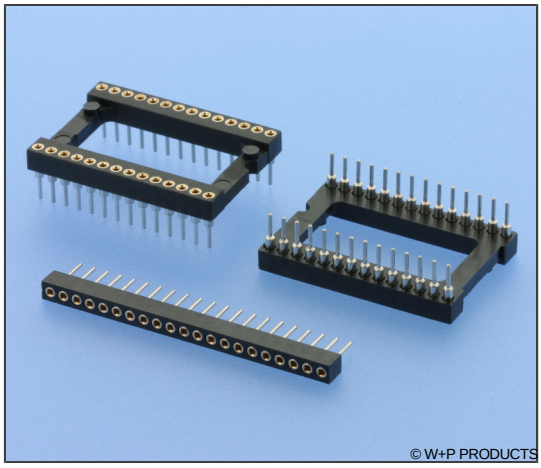
326 / 327

IC-Fassungen / IC-Leisten RM 1,78mm – Shrink DIP

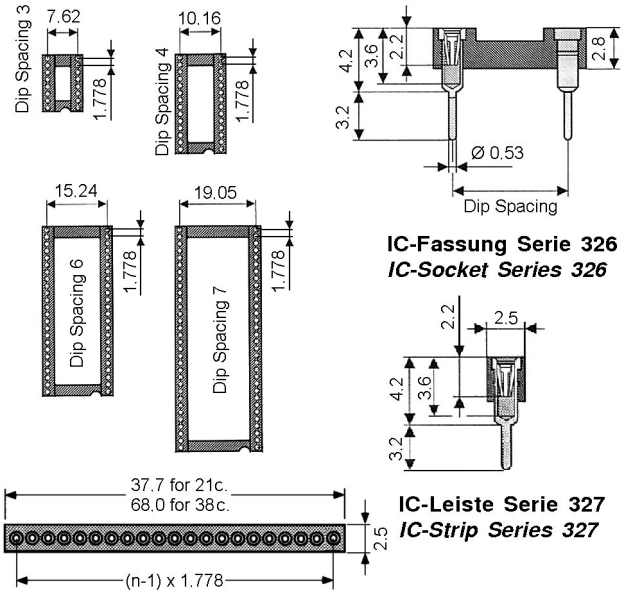
IC Sockets / IC Headers 1.78mm Pitch – Shrink DIP

Technische Daten / ***Technical Data***

Gehäuse/Abdeckung/Hebel	Thermoplast, nach UL94 V-0
Case/Cover/Actuator	*Thermoplastic, rated UL94 V-0*
Kontaktmaterial	Hülse: Messing gedreht Feder: 4-Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer
Contact Material	*Sleeve: screw machined brass* *Clip: 4-Finger-Clip, Beryllium-Copper*
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	*Acc. to options (see below), over Ni*
RoHS-Ausnahmen 6a-I / 6c	6c; ohne RoHS-Ausnahme mit Option -LF21
RoHS Exemptions 6a-I / 6c	*6c; Option -LF21 w/o RoHS-Exemption*
Durchgangswiderstand	< 10 mΩ
Contact Resistance	*< 10 mΩ*
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	*> 1000 MΩ*
Spannungsfestigkeit	1 kV RMS
Withstanding Voltage	*1 kV RMS*
Nennspannung	100 V RMS / 150 V DC
Voltage Rating	*100 V RMS / 150 V DC*
Nennstrom	1 A
Current Rating	*1 A*
Temperaturbereich	-55 °C ... +125 °C
Temperature Range	*-55 °C ... +125 °C*
Verarbeitung	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren
Processing	*Wave or reflow soldering*



Für Rundstifte Ø0,40-0,56mm
oder Vierkantstifte 0,25x0,45mm.
For Ø0.40-0.56mm round pins
or 0.25x0.45mm rectangular pins.



n	Type	DIP [mm]
16	3	7.62
28-32	4	10.16
48		
20	6	15.24
24		
28		
40/42		
48-52		
56		
64		
68		
64	7	19.05

Series	*Contacts**	*DIP-Spacing**	*Sleeve Plating*	*Clip Plating**	*Leadfree (Optional)**
326	**16**	**3**	**50**	**00**	**LF21**
326 IC-Fassung *IC-Socket*	**16/20/24/28-32/40/** **42/48/50/52/56/64/68** DIP Spacing Optionen entspr. Tabelle *DIP Spacing options* *pl. see table*	**3** 7,62mm **4** 10,16mm **6** 15,24mm **7** 19,05mm	**50** Verzinnt (Standard) *Tin plated (Standard)*	**00** Vergoldet *Gold plated* **10** Vergoldet 0,25µm (Option) *0,25µm gold plated (Option)* **30** Vergoldet 0,75µm *0,75µm gold plated*	**LF21** Auf Anfrage bleifrei ohne RoHS Ausnahme 6c *On request leadfree* *without RoHS* *exemption 6c*

Series	*Contacts**	*Rows*	*Sleeve Plating*	*Clip Plating**	*Leadfree (Optional)**
327	**21**	**1**	**50**	**00**	**LF21**
327 IC-Leiste *IC Header*	**21/38** Einreihig *Single row*	**1** Einreihig *Single row*	**50** Verzinnt (Standard) *Tin plated (Standard)*	**00** Vergoldet *Gold plated* **10** Vergoldet 0,25µm (Option) *0,25µm gold plated (Option)*	**LF21** Auf Anfrage bleifrei ohne RoHS Ausnahme 6c *On request leadfree* *without RoHS* *exemption 6c*

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
** This is an* ***order example*** *-*
please replace by your specifications.

Informationen zum Reflow-Lötverfahren
Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_S$min	150 °C
Temperatur Maximum $T_S$max	200 °C
Dauer $T_S$min – $T_S$max	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_S$max – T_P	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_P$max – $T_S$min	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_S$min	*150 °C*
Maximum Temperatur $T_S$max	*200 °C*
Duration $T_S$min – $T_S$max	*60 – 180s*
Soldering Range Temperature T_L	*217 °C*
Duration above T_L	*60 – 180s*
Ramp-Up Rate $T_S$max – T_P	*max. 3 °C / s*
Peak Temperature T_P	*260±5 °C*
Duration Peak Temperature	*20 – 40s*
Ramp-Down Rate $T_P$max – $T_S$min	*6 °C / s*
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	*max. 8min*

